

电子

DeepSeek 重构端侧 AI 部署可行性，AI 化终端加速渗透

投资要点：

➤ **DeepSeek 相继发布了开源大语言模型 V3 和 R1，凭借开源、极具成本优势、高性能已成为全球现象级模型。**2024 年底发布的 DeepSeek V3 通过算法创新和工程优化大幅提升模型效率，从而以不到 OpenAI GPT-4o 预算的 1/10 的训练成本，实现了与 GPT-4o 等顶尖模型相媲美的性能。在此基础上，DeepSeek 进一步推出的 R1 模型则聚焦推理优化，基于 V3 架构引入纯强化学习与多阶段强化学习结合监督微调的 R1 模型，极大提升了模型推理能力，在性能与 OpenAI 的 o1 正式版不相上下的同时，其服务价格更进一步压缩到 o1 的约 3%。当前，DeepSeek 应用已登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费 App 下载排行榜，在美区下载榜上超越了 ChatGPT，成为国内 AI 产业的发展的重大驱动力，并以其低成本高性能特性驱动 AI 应用的快速落地。

➤ **DeepSeek 通过蒸馏技术重构端侧 AI 部署可行性，AI 终端设备及产业链加速发展。**第三方可以从 DeepSeek-R1 中蒸馏出更多版本的小参数模型并部署至各类终端产品中，原始模型的参数量达到 671B，对推理硬件的要求高；而蒸馏模型有 1.5B-70B 六个版本，在保持性能的前提下将模型参数量压缩 90%+。端侧模型部署难度显著减小，并成功突破存储空间、算力消耗、推理延迟三大端侧部署障碍，可在手机、PC、ARVR 等可穿戴设备、汽车等端侧硬件本地化部署。在手机方面，包括 OPPO、荣耀、魅族等厂商均宣布已经完成了对 DeepSeek 模型的接入；在 PC 方面，DeepSeek 模型与国产算力芯片的适配也进展迅速，如国产 GPU 厂商沐曦与联想合作推出的 DeepSeek 智能一体机、英特尔 AI PC 合作伙伴 Flowy 在最新版的 AI PC 助手上率先支持了端侧运行 DeepSeek-R1 模型。DeepSeek 的推出有望加速端侧模型在广度和深度方面的发展，加速 AI 终端产品及其产业链环节出货量和渗透率的快速提升。

投资建议

推理侧算力方面，关注 SoC 芯片，如瑞芯微、全志科技、北京君正、晶晨股份、炬芯科技、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝讯等；关注存储容量的需求扩容，如兆易创新、佰维存储、江波龙、普冉股份等；以及 PCB 以及服务器等硬件环节，如胜宏科技、沪电股份等。

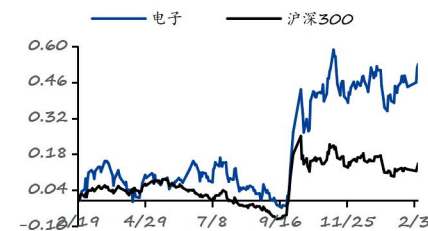
终端硬件方面，关注 AI PC、AI 手机、AI 智能眼镜、AI 玩具、AIOT 等端侧 AI 渗透加速带来的产业链机会，如华勤技术、立讯精密、领益智造、飞荣达、思泉新材、龙旗科技、统联精密、苏大维格、奋达科技、春秋电子、福蓉科技、宇环数控、水晶光电、TCL 科技、京东方 A、聚飞光电、兆驰股份、瑞丰光电等。

风险提示

国产大模型迭代不及预期；下游终端出货不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；行业景气不及预期。

强于大市（维持评级）

一年内行业相对大盘走势



团队成员

分析师： 杨钟(S0210522110003)
 YZ3979@hfzq.com.cn
研究助理： 詹小璿(S0210123120002)
 zxm30169@hfzq.com.cn

相关报告

- 1、台积电 24Q4 业绩亮眼，AI 和 HPC 持续驱动增长——2025.01.20
- 2、汽车智能化提速，关注车载摄像头机遇——2025.01.13
- 3、CES 2025 启幕在即，AI 浪潮涌动——2024.12.30



正文目录

1 本周市场表现.....	3
1.1 电子板块本周表现.....	3
1.2 SW 电子个股本周表现.....	3
1.3 电子板块估值分析.....	4
2 行业动态跟踪.....	6
2.1 半导体板块.....	6
2.2 消费电子.....	9
2.3 汽车电子板块.....	12
2.4 面板板块.....	13
3 公司动态跟踪.....	13
4 风险提示.....	15

图表目录

图表 1: SW 各行业板块本周市场表现.....	3
图表 2: 电子板块成交额及日涨跌幅.....	3
图表 3: 电子细分领域本周涨跌幅 (%).....	3
图表 4: SW 电子本周涨幅前十个股 (%).....	4
图表 5: SW 电子本周跌幅前十个股 (%).....	4
图表 6: SW 电子本周换手率前二十个股 (%).....	4
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM).....	5
图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM).....	5
图表 9: 过去一周股东增减持更新.....	13
图表 10: 过去一周股权激励一览.....	14

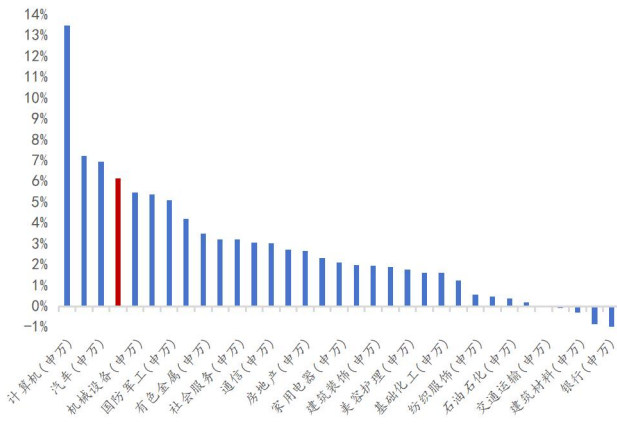


1 本周市场表现

1.1 电子板块本周表现

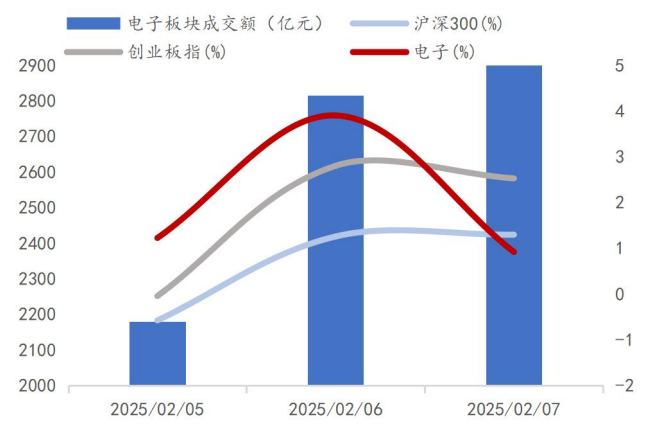
大盘表现上，本周（0203-0207）创业板指数上涨 5.36%，沪深 300 指数上涨 1.98%。本周电子行业指数上涨 6.14%。行业表现上，电子行业涨跌幅位列全行业的第 4 位，本周计算机、传媒、汽车涨跌幅位居前列。

图表 1: SW 各行业板块本周市场表现



来源: Wind, 华福证券研究所

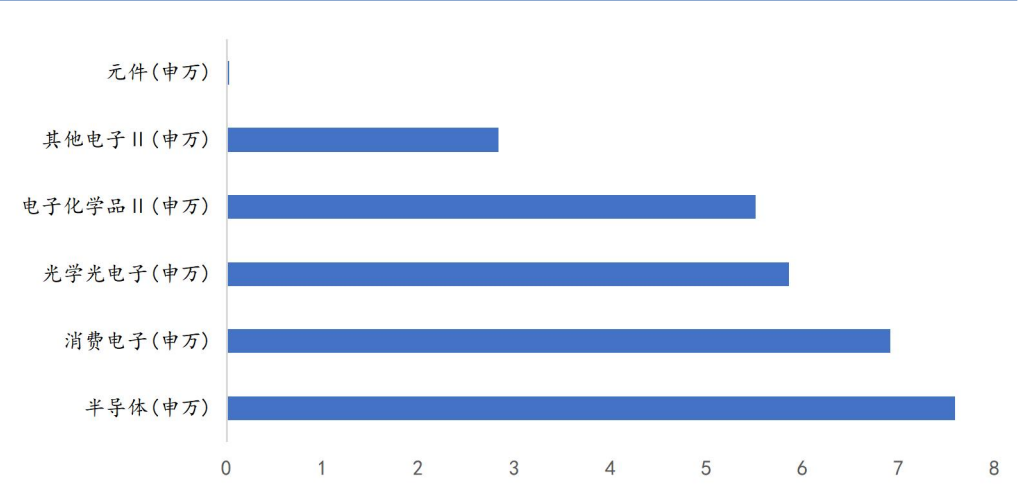
图表 2: 电子板块成交额及日涨跌幅



来源: Wind, 华福证券研究所

从电子细分行业指数看，本周电子细分板块普涨，具体来看，半导体板块涨幅最大，周涨跌幅为 7.59%；元件涨幅最小，周涨跌幅为 0.03%。

图表 3: 电子细分领域本周涨跌幅 (%)

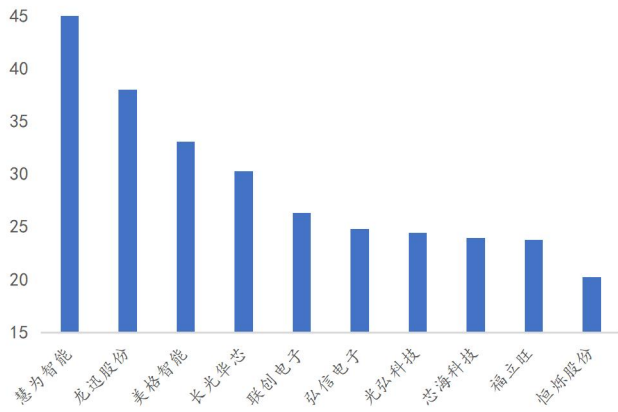


来源: Wind, 华福证券研究所

1.2 SW 电子个股本周表现

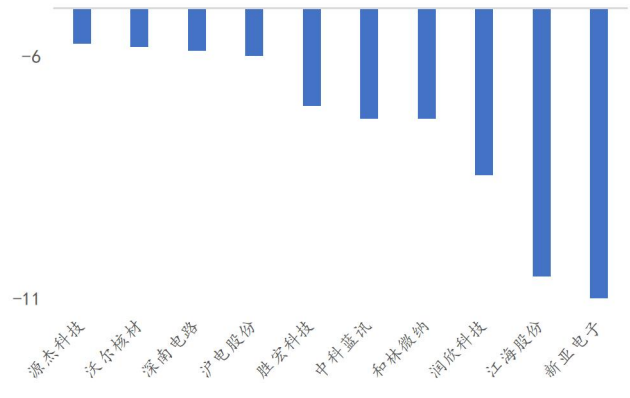
从个股维度来看，SW 电子板块中，慧为智能 (45.59%)、龙迅股份 (38.02%) 等位列涨幅前列；新亚电子 (-11.14%)、江海股份 (-10.53%) 等位列跌幅前列。

图表 4: SW 电子本周涨幅前十个股 (%)



来源: Wind, 华福证券研究所

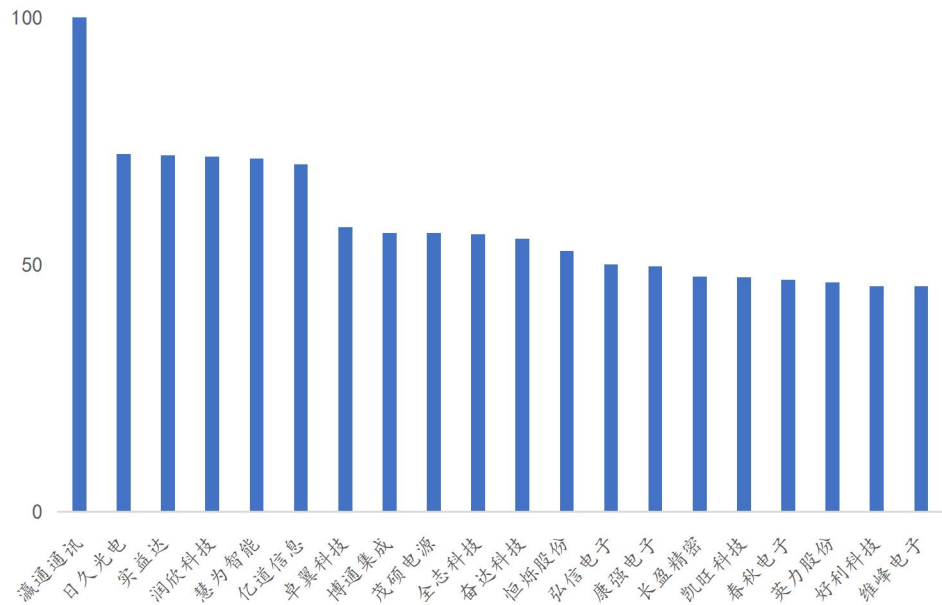
图表 5: SW 电子本周跌幅前十个股 (%)



来源: Wind, 华福证券研究所

从换手率来看,本周电子行业个股换手率最高的是瀛通通讯,换手率为 102.35%。其余换手率较高的还有日久光电(72.43%)、实益达(72.13%)、润欣科技(71.96%)。

图表 6: SW 电子本周换手率前二十个股 (%)



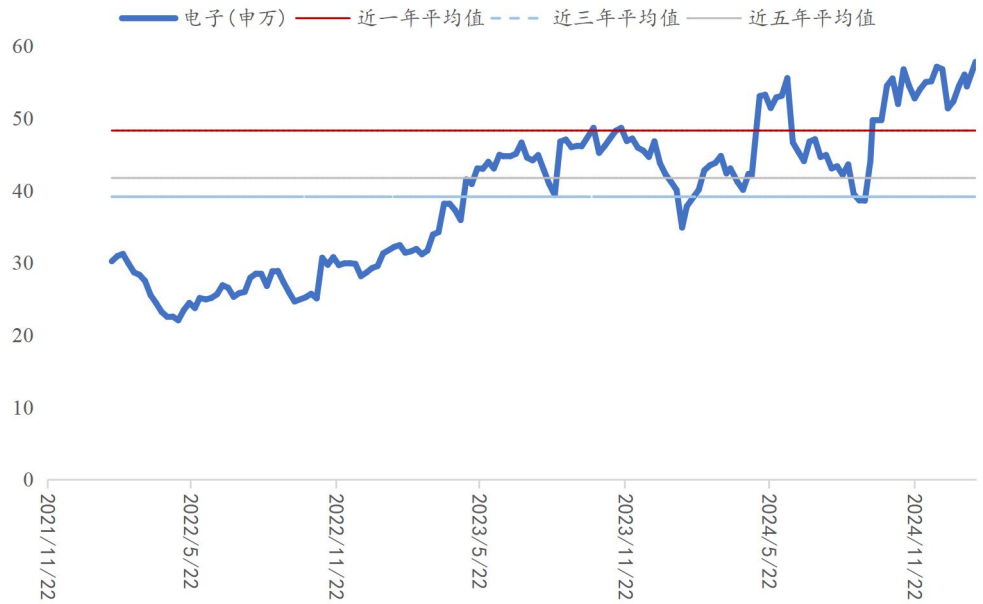
来源: Wind, 华福证券研究所

1.3 电子板块估值分析

从本周 PE 走势来看,本周整体电子行业估值高于近一年、三年、五年平均值水平。本周 PE (TTM) 为 57.81 倍,较上周上调。



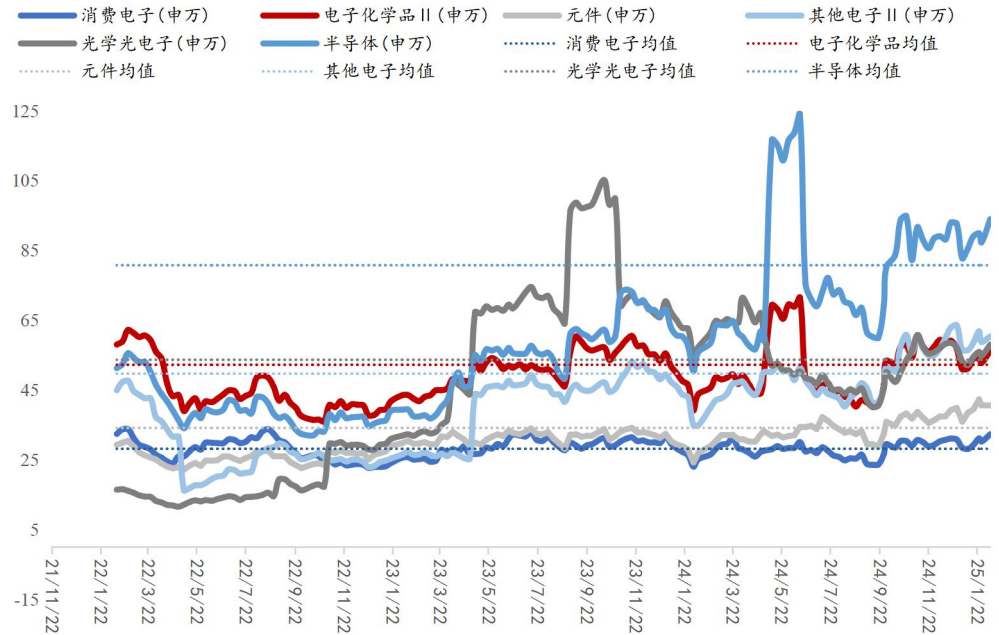
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)



来源: Wind, 华福证券研究所

细分领域上, 本周消费电子、电子化学品、元件、其他电子、光学光电子和半导体板块 PE 分别为 32.29、56.21、40.49、60.32、57.96 和 93.91。本周除元件有所回调外, 其他电子细分板块估值均有所上涨。

图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)



来源: Wind, 华福证券研究所

2 行业动态跟踪

2.1 半导体板块

1) SIA: 全球芯片市场 2024 年销售额首超 6000 亿美元, 创历史新高

半导体行业协会 (SIA) 公布的数据显示, 2024 年全球半导体销售额达到 6276 亿美元, 比 2023 年的 5268 亿美元增长了 19.1%。此外, 第四季度销售额为 1709 亿美元, 比 2023 年同期增长了 17.1%, 比 2024 年第三季度增长 3.0%。

2024 年 12 月的全球销售额为 570 亿美元, 比 2024 年 11 月下降了 1.2%。

SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示: “全球半导体市场在 2024 年经历了有史以来最高的销售额年份, 年销售额首次超过 6000 亿美元, 预计 2025 年市场将实现两位数增长, 行业的长期前景非常强劲。”

从地区来看, 美洲 (44.8%)、中国 (18.3%) 和除中国和日本以外的亚太/其他地区 (12.5%) 的年度销售额有所增长, 而日本 (-0.4%) 和欧洲 (-8.1%) 的销售额有所下降。12 月份的月度销售额在美洲增长了 3.2%, 但在除中国和日本以外的亚太/其他地区 (-1.4%)、中国 (-3.8%)、日本 (-4.7%) 和欧洲 (-6.4%) 有所下降。(资料来源: 集微网)

2) TEL: 人工智能将推动芯片设备市场实现两位数增长

2 月 6 日, 日本芯片制造设备供应商 Tokyo Electron (TEL) 表示, 由于智能手机和个人电脑的人工智能增加了对先进制造设备的强劲需求, 明年芯片设备市场将出现“两位数的增长”。

TEL CEO Toshiki Kawai 在一次在线会议上表示: “用于数据中心的尖端逻辑芯片和用于人工智能智能手机和个人电脑的存储芯片都有望在 2026 年推动先进芯片设备市场, 这一趋势将推动公司的业绩进一步增长。”

TEL 预计, 在截至 3 月份的当前财年, 该公司的销售额将达到创纪录的 2.4 万亿日元 (合 157 亿美元)。

近年来, TEL 正享受着来自中国新芯片制造商的需求, 因为美国对中国先进半导体的出口管制刺激了这些制造商建立自己的芯片能力。该公司目前向中国销售的是老一代芯片设备, 因为日本限制向中国出口先进的设备。Kawai 称, 在截至 2026 年 3 月的下一个财年, 面向中国市场的销售额占总销售额的比例将从当前财年的 40% 以上降至 35% 左右。但这不会减少公司的利润, 因为公司专注于高价值设备, 并致力于提高毛利率。(资料来源: 集微网)

3) 机构: 2025 年全球半导体市场将增至 7050 亿美元 HBM 营收 198 亿美元

根据市场调查机构 Gartner 的数据, 全球半导体收入预计将在 2025 年增长



12.6%，达到 7050 亿美元。

市场分析师表示，这将由人工智能需求推动，并在 2024 年强劲增长之后实现。2024 年半导体收入将达到 6260 亿美元，比 2023 年增长 18.1%。

分厂商来看，三星电子是 2024 年排名第一的半导体供应商，年销售额增长 62.5%，超过排名第二的英特尔。由于对 AI 加速芯片的需求，英伟达的芯片销售额几乎翻了一番，跃居第三位。

存储制造商 SK 海力士和美光的销售额也出现强劲增长。就美光而言，三星和 SK 海力士的销售额增长主要得益于存储的高平均售价，尤其是数据中心 AI 加速所需的高带宽存储器（HBM）。Gartner 表示，2024 年数据中心应用芯片的销售额几乎翻了一番，达到 1120 亿美元。

Gartner 指出，2024 年非存储收入将增长 6.9%，而存储收入将增长 71.8%。因此，到 2024 年，存储在半导体总销售额中的份额将增至整个市场的 25.2%，非存储占 74.8%。

Gartner 分析师 George Brocklehurst 指出：“存储和 AI 半导体将推动近期增长，HBM 预计将占据 DRAM 收入的越来越大份额，到 2025 年将达到 19.2%。HBM 收入预计在 2025 年将增长 66.3%，达到 198 亿美元。”（资料来源：集微网）

4) 台积电：2025 年营收将达千亿美元，未来五年将以近 20% CAGR 增长

近日，台积电董事长魏哲家发布了对 2025 年及未来五年的强劲成长预期。2025 年将是台积电强劲成长的一年，全年营收有望达到千亿美元的里程碑。这一预期不仅超过了市场普遍预期。展望未来五年，台积电预期营收将以接近 20% 的年复合成长率稳健增长，增长动能将主要来自智能手机、HPC（高性能计算）、物联网和汽车等四大应用平台。魏哲家持续看好全球 AI 渗透率的不断扬升，认为这将为台积电带来持续的业务增长和市场份额提升。

为了支撑其强劲的成长预期，台积电在 2025 年的资本支出也将持续增长。魏哲家透露，2025 年的资本支出将达到 380 亿-420 亿美元，这一数字优于市场原先预期的上缘 400 亿-410 亿美元。在资本支出的分配上，台积电将约 70% 的资金投入先进制程技术，以巩固其在高端市场的领先地位。同时，10%-20% 的资金将用于特殊制程技术，以满足客户对定制化解决方案的需求。另外 10%-20% 的资金则投入先进封装、测试及其他项目，以拓展其在封装和测试领域的市场份额。

在先进封装方面，台积电上季的先进封装比重相较过往有所提升，这消除了外界对 CoWoS 需求下降的杂音。魏哲家强调，台积电将持续增加 CoWoS 产能，以满足客户需求。预计 2025 年，CoWoS 的全年营收贡献将从去年的 8% 成长至 10%，获利也将比之前有所进步。



台积电在制程技术方面也保持领先地位。魏哲家透露，2nm 制程预计将在下半年如期量产，产能提升曲线预期将与 3nm 制程相似。同时，台积电已推出 N2P 制程作为 2nm 家族的延伸，计划于 2026 年下半年量产。采用创新超级电轨（SPR）技术的 A16 制程也将于 2026 年下半年量产，为 HPC 产品提供更优异的效能表现。（资料来源：集微网）

5) 三星 2nm 工艺 SF2 试产良率超预期，Exynos 2600 量产计划稳步推进

据韩媒披露，三星电子近日取得了在 Exynos 2600 试生产中的初步成功，其 2nm 工艺（SF2）的良率达到了高于预期的 30%。这一工艺被预期在今年下半年进行量产，并且这一良品率还有望进一步提升。三星电子正在投入大量资源确保 Exynos 2600 能够如期量产。

SF2 是三星电子代工部门计划在今年下半年量产的最新工艺，采用第三代 GAA 工艺。与 SF3 相比，SF2 的性能有望提高 12%，能效提高 25%，面积微缩 5%。三星电子的 Exynos 2600 预计将用于明年第一季度发布的 Galaxy S26。

此前，三星电子最初计划在 Galaxy S25 中应用 Exynos 2500，但由于良率问题而推迟量产。Galaxy S25 最终采用了高通骁龙 8 至尊版芯片。如果 Exynos 2600 的量产再次推迟，那么不仅三星电子，韩国的代工生态系统也将遭受打击。

目前，已知引入三星 2nm 工艺的公司只有日本 Preferred Networks（PFN）和美国 AI 半导体公司 Ambarella，他们使用的是 SF2X（用于 AI-HPC）和 SF2A（用于汽车）。三星电子正在与各种应用领域的一级客户进行讨论，以确保 2nm 工艺的订单。（资料来源：集微网）

6) 2024 年晶圆代工市场年增长 22%，台积电 2025 年持续维持领头羊地位

根据市场调查及研究机构 Counterpoint Research 的最新报告显示，2024 年全球晶圆代工市场以 22% 的年增长率结束，展现出 2023 年之后的强劲复苏与扩张动能。

报告表示，此增长主要来自于先进制程需求的激增，受 AI 应用加速导入数据中心与边缘计算所驱动。而晶圆代工领头羊台积电则凭借 5/4nm 与 3nm 先进制程的强劲需求，抓住市场机会，加上 CoWoS 等先进封装技术的发展，也进一步助推产业增长。

而报告还指出，晶圆代工产业将在 2025 年挑战 20% 的营收增长，其中 AI 需求持续强劲，为台积电等主要厂商带来显著助益。此外，消费电子、网通设备与蜂窝式物联网等非 AI 半导体应用的需求回温，也将支撑市场增长，进一步强化产业的长期潜力。2025 年，3nm 与 5/4nm 等先进制程的产能利用率（UTR）预计将维持在高水准，受惠于英伟达带动的 AI 需求，以及苹果高通与联发科的旗舰智能手机出货。

(资料来源：集微网)

7) 日月光投控扩大扩 CoWoS 先进封装，与英伟达合作更紧密

英伟达首席执行官黄仁勋年前到中国台湾，业界传出，日月光投控旗下矽品接下 CoWoS 产能中 CoW 制程订单后，集团全面向 AI 进军，高雄厂建置先进封装新产能，矽品中科及虎尾厂也同步建置新产线，下半年有望量产，大幅拉高日月光集团在先进封装的占比。

日月光投控和台积电是长期合作伙伴，近几年在 AI 芯片主要客户英伟达的强劲需求下，台积电先进封装 CoWoS 产能供不应求，但受惠英伟达 CoWoS-L 订单外溢效应，日月光在去年第四季接获相关订单，并规划在高雄 K18 厂扩大产能，预计 2026 年 K28 完工投产。针对订单传言，日月光投控不予回应。

日月光去年第三季时斥资 52.63 亿元新台币，购入 K18 厂以及旁边的化学品仓库，日月光指出，该厂将用于扩充先进封装产能。

业界指出，日月光 K18 厂为先进封装生产基地，相关设备将在今年上半年开始进机，并在今年下半年进入量产阶段。虽然产能在下半年逐步开出，但新产能贡献下，市场看好，该厂投入也将是日月光今年在先进封装运营占比持续倍增的重要动能。(资料来源：集微网)

2.2 消费电子

1) 机构发布 2024 年全球智能手机销量榜：苹果第一，小米第三

2月5日，市调机构 Canalys 在报告中指出，2024 年全球智能手机市场增长 7%，达到 12.2 亿部，实现了在连续两年下滑后的反弹。

从厂商排名看，苹果凭借新兴市场的增长以及北美和欧洲的稳定表现，成功抵消了其在中国大陆市场的挑战，连续第二年稳守市场榜首。2024 年全年，iPhone 出货量下降 1%至 2.259 亿部。三星紧随其后，继续聚焦盈利能力，其出货量同样下降 1%至 2.229 亿部。小米稳居第三，并成为 2024 年行业出货量增长的最大贡献者。受中国大陆市场的强劲势头以及在新兴市场的持续战略扩张推动，小米出货量增长 15%，达到 1.686 亿部。传音首次跻身第四，而 OPPO (包括一加) 位列第五，分别增长 15%和 3%至 1.067 亿部和 1.036 亿部。

Canalys 分析师 Runar Bjørhovde 表示：“2024 年是智能手机市场的复苏之年，实现了疫情后年度全球出货量的最高水平。大众市场需求激增，主要受到疫情期间购买的智能手机进入换机周期以及渠道补货的推动。多家厂商抓住这一趋势，专注开放市场渠道，并推出高性价比产品以吸引消费者。然而，在扩大出货量的同时，为了保持价格竞争力，厂商也面临利润率下降的风险。为应对这一挑战并维持盈利



能力，厂商纷纷削减固定成本并优化资源规划。除了新兴市场的强劲增长，成熟经济体也开始复苏，例如，中国大陆市场增长 4%，北美增长 1%，欧洲增长 3%。这些地区的需求回暖得益于厂商的大力度促销，包括折扣、以旧换新和设备捆绑销售等多种渠道策略。”（资料来源：集微网）

2) OPPO/荣耀/魅族等手机品牌完成 DeepSeek-R1 大模型接入

DeepSeek 自 2024 年底以来相继发布了开源大语言模型 V3 和 R1，并在多项评测中表现优于主流开源模型，并极具成本优势，显著降低了对硬件资源的需求。1 月 27 日，Deepseek 应用登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费 App 下载排行榜，并在美国地区下载榜上超越了 ChatGPT。

伴随着 DeepSeek 模型的火热，包括 OPPO、荣耀、魅族等厂商均宣布已经完成了对 DeepSeek 模型的接入。

2 月 8 日，OPPO 宣布 Find N5 将正式接入 DeepSeek-R1，并可通过语音唤醒直接使用。Find N5 将于本月发布。

同日，荣耀 YOYO 智能体商店上线 DeepSeek-R1 尝鲜版，荣耀手机系统版本 MagicoS8.0 及以上用户，将 YOYO 助理升级到 80.0.1.503 版本及以上即可体验。

另外，星纪魅族 Flyme AIOS 已完成 DeepSeek-R1 大模型接入。下周起魅族 21 系列、Lucky 08 率先上线，星纪魅族 StarV AR 眼镜等 AI 生态产品将陆续接入。据了解魅族 20 系列机型也在对接适配中。（资料来源：集微网）

3) 两周后亮相！OPPO Find N5 官宣：全球最薄折叠屏旗舰

去年 10 月 19 日，OPPO 发布了全新一代超高端旗舰 OPPO Find N3，在设计、影像、安全、交互等方面迎来了全新的折叠旗舰体验，尤其带来了折叠屏领域内最好的影像表现，一经亮相便受到了用户的广泛好评。而在近期，该系列的下一代产品——OPPO Find N5 也迎来了密集曝光。现在有最新消息，随着春节假期的结束，这款新机也正式迎来了官宣。

据 OPPO 官方最新发布的信息显示，全球最薄折叠屏旗舰 OPPO Find N5 将于两周后正式亮相。结合此前相关爆料，这款新品将搭载高通骁龙 8 至尊版移动平台，并且还做到了全球最薄设计，折叠态厚度不到 9.2mm，单边厚度在 4mm 左右，刷新了折叠屏的厚度纪录。不仅是全球第一款骁龙 8 至尊版折叠屏，也是迄今为止机身最薄、性能最强悍的折叠屏旗舰。（资料来源：Techweb）

4) 创历史新高！2024 年全球智能手机平均售价达 2594 元

2 月 7 日消息，据 Counterpoint 调研数据显示，受高端化趋势推动，2024 年全球智能手机收入同比增长 5%。



同时，平均销售价格（ASP）也同步上涨 1%，达到 356 美元（约合 2594 元人民币），为历年最高。

分析师 Shilpi Jain 表示：“2024 年智能手机市场有许多积极因素，平均销售价格和出货量均有所增长。收入增长继续超过出货量增长，平均销售价格创下新纪录，这得益于手机品牌厂商对高端市场的持续关注、消费者对高端设备的需求增加以及投入成本的上升。

展望 2025 年，智能手机出货量可能会以个位数增长，而平均销售价格和收入将继续超过出货量增长。低价 5G 手机以及 GenAI 技术向中低端市场的普及是 2025 年值得关注的趋势。”（资料来源：Techweb）

5) 机构发布 2024 年 Q4 全球笔记本电脑销量榜：联想第一、惠普第二

2 月 8 日，市调机构 TechInsights 在报告中指出，2024 年 Q4，全球笔记本电脑出货量同比增长了 6%，达到 5450 万台。

从厂商排名上看，2024 年 Q4，联想笔记本电脑出货量仍保持市场领先地位，同比增长 7%。惠普以 21% 的市场份额依旧占据第二的位置。戴尔持续挣扎，同比下降 1%，这已是其连续第三个季度下滑。苹果于 10 月底推出的搭载 M4 芯片的 MacBook Pro 推动了出货量增长至 600 万台，同比仅增长 1%。华硕在该季度笔记本电脑出货量为 410 万台，继续领先宏碁。

TechInsights 表示，随着市场加速迈向 2025 年末 Windows 10 服务终止日期，商用需求依然强劲。尽管消费需求较为平淡，但在假日季度还是有所增长，零售商和供应商大幅打折促销电脑，吸引注重价格的消费者。中国提供的政府补贴达到了预期效果，刺激了消费需求。（资料来源：集微网）

6) 机构：2024 年全球平板电脑出货 1.476 亿台，小米跃居第五

2 月 6 日，市调机构 Canalys 在报告中指出，2024 年第四季度，全球平板电脑出货量同比增长 5.6%，达到 3990 万台。这使得 2024 年全年总出货量达到 1.476 亿台，同比增长 9.2%，相比 2023 年呈现出稳健复苏态势。除北美外，所有地区均实现增长。

从厂商表现看，2024 年，中国厂商在平板市场表现强劲。小米增长尤为亮眼，年增长率高达 73%，超过亚马逊，跃居全球第五。华为同样实现 29% 的增长，攀升至全球第三。联想位列第四，出货量达 1000 万台，同比增长 12%。苹果在 2024 年第四季度实现 14% 的增长，并在全年录得 5.3% 的增长，单季度 iPad 出货量达到 1690 万台。这一增长主要受新款 iPad Mini 和 iPad Air 的推动。三星则位居全球第二，单季出货量 710 万台，年增长率为 3.9%。（资料来源：集微网）



2.3 汽车电子板块

1) 乘联会预估：1月全国新能源车销量同比增长31%

据乘联会初步统计，1月1-31日，乘用车市场零售185.3万辆，同比去年同期下降9%，较上月同期下降30%，今年以来累计零售185.3万辆，同比下降9%；1月1-31日，全国乘用车厂商批发204.8万辆，同比去年同期下降3%，较上月同期下降33%，今年以来累计批发204.8万辆，同比下降3%。

1月1-31日，新能源乘用车市场零售78.6万辆，同比去年同期增长17%，较上月同期下降40%，今年以来累计零售78.6万辆，同比增长17%；1月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发90万辆，同比去年同期增长29%，较上月同期下降40%，今年以来累计批发90万辆，同比增长29%。

乘联会初步数据显示，特斯拉中国1月新能源乘用车批发销量63238辆；比亚迪1月新能源车销量296446辆；吉利汽车1月新能源车销量121071辆。（资料来源：集微网）

2) 2024年汽车整车出口640.7万辆 同比增长22.7%

2月6日，据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2024年汽车整车出口640.7万辆，同比增长22.7%；出口金额达1173.5亿美元，同比增长15.5%。其中，12月，汽车整车出口57.4万辆，环比增长4.6%，同比增长24.9%；出口金额99.9亿美元，环比增长10.1%，同比增长12.1%。

根据乘联会发布数据，目前，中国整车出口量前三大目的国为俄罗斯、墨西哥和阿联酋。2024年前11个月数据显示，1—11月整车出口总量的前十的国家：俄罗斯106万辆、墨西哥42.22万辆、阿联酋29.19万辆、比利时25.76万辆、沙特24.24万辆、巴西22.82万辆、英国18.08万辆、澳大利亚16.27万辆、菲律宾15.48万辆、土耳其12.56万辆。

2024年1—11月新能源汽车出口总量前五的国家：比利时24.23万辆、巴西14.99万辆、英国11.20万辆、泰国10.59万辆、菲律宾10.57万辆。

近年来，汽车出口额占中国出口额呈逐年增长趋势。2022年、2023年、2024年，中国汽车出口额分别601亿美元、1016亿美元、1174亿美元，占比由2022年1.7%提升至2024年3.3%。

对于2025年，崔东树预测，考虑到俄罗斯市场或将面临负增长，欧洲市场面临较大关税压力，因此2025年汽车出口预计增长10%，纯电动汽车出口或为零增长。（资料来源：集微网）



2.4 面板板块

1) 机构：显示面板厂商计划 Q1 将工厂利用率提升至 80%

2月6日，市调机构 Omdia 在报告中指出，2024 年第四季度，显示面板厂商持续提高其工厂利用率计划，截至 11 月底，第四季度的利用率计划为 77%。到 12 月底，该计划被上调了两个百分点至 79%，而 2025 年一季度的计划又被上调了四个百分点，使得季度利用率超过 80%。

Omdia 显示研究首席分析师 Alex Kang 表示：“工厂利用率计划的上调主要受中国大陆政府‘以旧换新’补贴计划推动的特殊电视面板需求增加的驱动，该补贴计划尚未完全实现。中国大陆领先的电视厂商正在通过确保获得额外的电视面板来定位自己，以便在这次需求激增期间占据更大的市场份额。”

“新当选的美国政府预期中的关税风险暂时推高了液晶电视面板的需求，影响了面板厂商的工厂利用率计划。一些中国大陆电视厂商正在增加墨西哥的电视库存，以方便向美国市场发货。此外，紧急订单也加剧了驱动器 IC（集成电路）和偏光片等部件短缺的风险，尤其是 IT 液晶显示器的制造。对这些供应问题的担忧进一步推动了需求，导致工厂利用率计划再次上调。” Alex 补充道。

Omdia 指出，面板厂商工厂利用率计划的上调主要由京东方、华星光电和惠科等中国大陆主要面板制造商引领。由于这些面板制造商在中国大陆液晶电视面板生产和供应给中国电视制造商方面的份额较高，因此受政府补贴计划的影响更大。（资料来源：集微网）

3 公司动态跟踪

图表 9：过去一周股东增减持更新

证券代码	证券简称	公告日期	方向	股东名称	股东身份	拟变动数量上限	拟变动数量上限占总股本比(%)
301366.SZ	一博科技	2025-02-05	减持	深圳市领誉基石股权投资合伙企业	持股 5%以上股东	1,488,405.00	1.00
300602.SZ	飞荣达	2025-02-07	减持	宁波飞驰荣达股权投资有限公司	特定股东	600,000.00	0.10
300602.SZ	飞荣达	2025-02-07	减持	王林娜	财务总监	25,000.00	0.00
300602.SZ	飞荣达	2025-02-07	减持	马军	董事, 副总经理	630,000.00	0.11
300456.SZ	赛微电子	2025-02-07	减持	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	持股 5%以上股东	10,983,196.00	1.50
301489.SZ	思泉新材	2025-02-07	减持	廖晓飞	股东, 董事, 高级管理人员	1,000,000.00	1.73
301489.SZ	思泉新材	2025-02-07	减持	吴攀	股东, 董事, 高级管理人员	1,000,000.00	1.73
603890.SH	春秋电子	2025-02-08	减持	薛赛琴	5%以下股东	5,000,000.00	1.14
300398.SZ	飞凯材料	2025-02-08	减持	上海半导体装备材料产业投资管理	持股 5%以上股东	10,533,608.00	2.00

代码	名称	公告日期	方案进度	激励方式	激励总数 (万)	激励总数占当时总股本比例 (%)	期权初始行权价格
301041.SZ	金百泽	2025-02-05	减持	张伟	1,061,351.00	0.99	
688608.SH	恒玄科技	2025-02-08	减持	Run Yuan Capital I Limited, Run Yuan Capital II Limited	1,200,000.00	1.00	
870357.BJ	雅葆轩	2025-02-06	减持	孙昌来	1,601,600.00	2.00	
300857.SZ	协创数据	2025-02-06	减持	协创智慧科技有限公司	7,357,654.00	3.00	
688322.SH	奥比中光-UW	2025-02-08	减持	上海云鑫创业投资有限公司	12,000,000.00	3.00	
688515.SH	裕太微-U	2025-02-06	减持	李海华	800,000.00	1.00	
002156.SZ	通富微电	2025-02-06	减持	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	45,527,907.00	3.00	
300088.SZ	长信科技	2025-02-06	减持	新疆润丰股权投资企业	14,500,000.00	0.60	
603703.SH	盛洋科技	2025-02-08	减持	国交北斗(海南)科技投资集团有限公司	12,449,463.00	3.00	
688702.SH	盛科通信-U	2025-02-08	减持	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	12,300,000.00	3.00	
688099.SH	晶晨股份	2025-02-08	减持	Amlogic (HongKong) Limited	16,330,657.00	3.90	
688380.SH	中微半导	2025-02-06	减持	蒋智勇	4,050,000.00	1.01	
688380.SH	中微半导	2025-02-06	减持	罗勇	3,883,509.00	0.97	
688538.SH	和辉光电-U	2025-02-06	减持	上海集成电路产业投资基金股份有限公司, 上海科技创业投资(集团)有限公司	276,640,000.00	2.00	
688536.SH	思瑞浦	2025-02-08	减持	苏州金樱创业投资合伙企业	1,326,014.00	1.00	
600237.SH	铜峰电子	2025-02-07	增持	铜陵中旭产业投资有限公司			
300909.SZ	汇创达	2025-02-05	减持	段志刚	1,317,500.00	0.76	

来源: Wind, 华福证券研究所

图表 10: 过去一周股权激励一览

代码	名称	公告日期	方案进度	激励方式	激励总数 (万)	激励总数占当时总股本比例 (%)	期权初始行权价格
603296.SH	华勤技术	2025-02-05	股东大会通过	上市公司提取激励基金买入流通股	348.11	0.3427	34.34
688325.SH	赛微微电	2025-02-08	实施	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	67.00	0.7887	25.53
605111.SH	新洁能	2025-02-06	实施	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	105.36	0.2537	29.12
688325.SH	赛微微电	2025-02-08	实施	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	67.00	0.7887	25.53
688800.SH	瑞可达	2025-02-07	实施	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	500.00	3.1562	51.03

来源: Wind, 华福证券研究所



4 风险提示

国产大模型迭代不及预期；下游终端出货不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；行业景气不及预期。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在 20%以上
	持有	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于 10%与 20%之间
	中性	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与 10%之间
	回避	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来 6 个月内，行业整体回报高于市场基准指数 5%以上
	跟随大市	未来 6 个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来 6 个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）

联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 MT 座 20 层

邮编：200120

邮箱：hfjys@hfzq.com.cn